

2025 中国国际低温键合 3D 集成技术研讨会

国际低温键合 3D 集成技术 (LTB-3D) 研讨会是由日本非营利协会-先进微系统集成协会 (IMSI) 主办的重要会议, 该会议在技术上由美国电化学学会和 IEEE EPS 日本分会共同指导。2025 年该研讨会将首次在中国举行, 这将促进国际半导体低温键合 3D 集成技术合作与交流, 也将推动中国集成电路产业和新质生产力的发展。2025 中国国际低温键合 3D 集成技术研讨会由中国科学院微电子研究所、日本先进微系统集成协会、西安电子科技大学、中国电子学会、中国电子材料行业协会和青禾晶元半导体科技(集团)有限责任公司等共同主办。

本次研讨会将聚焦低温键合 3D 集成技术这一主题, 重点研讨技术的最新进展和未来的发展方向。重点面向与低温键合工艺相关的 3D 集成技术前沿方向, 包括表面活化键合 (SAB) 和原子扩散键合 (ADB) 等。这些技术将通过材料异质集成和器件异构集成实现新型器件结构, 为半导体器件、光子系统和电力电子系统的器件 3D 集成和模块集成带来颠覆性创新。这些技术应用的器件批量生产后将对集成电路产业发展产生巨大的应用价值。

我们热忱邀请您参加本次会议, 期待与大家在天津相聚。

重要信息:

摘要投稿截止时间: 2025 年 5 月 6 日

录取通知时间: 2025 年 6 月 10 日

最终的稿件确认时间: 2025 年 6 月 30 日

会议时间: 2025 年 8 月 3 日- 8 月 4 日

会议酒店: 天津, 海河悦榕庄酒店

注册费:

类别	提前注册(5 月 6 日前)	常规注册(5 月 7 日后)
普通	RMB:3000.00 ; JPY:60000.00 ; USD:420.00	RMB:3300.00 ; JPY:68000.00 ; USD:480.00
会员	RMB:2400.00 ; JPY:48000.00 ; USD:340.00	RMB:2640.00 ; JPY:54400.00 ; USD:384.00
学生	RMB:2000.00 ; JPY:20000.00 ; USD:300.00	RMB:2000.00 ; JPY:20000.00 ; USD:300.00

*会员: 日本先进微系统集成协会、中国电子学会、中国电子材料行业协会、程序委员会/组织委员会

注册网站: <https://ltb-3d-china-2025.tiemeeting.com/EN>

主办方:

中国科学院微电子研究所
西安电子科技大学
中国电子材料行业协会

日本先进微系统集成协会
中国电子学会
青禾晶元半导体科技(集团)有限责任公司

